



半导体行业点评：代工龙头产能扩增速度放缓 Q4 晶圆出货量跌价稳



核心要点:

Q3 晶圆出货量跌价涨，代工龙头毛利率微幅上行 PC、智能手机等产品的需求持续萎靡导致晶圆的出货量出现下跌，Q3 单季代工龙头联电、中芯国际的产能利用率下滑；台积电的晶圆季度出货量保持增长，但公司 7nm 受大客户联发科、超微等砍单影响，产能利用率位于低位；华虹半导体产能利用率为 110.8%，维持高位满载运行。受益于需求结构性增长，代工龙头调整优化产品组合，Q3 晶圆 ASP 保持增长，台积电/联电/华虹半导体的毛利率微幅上行。

Q4 晶圆出货量预计下行，需求结构性增长护航 ASP 走势平稳下游消费电子的需求尚未出现好转迹象，客户端仍处于去库存阶段，台积电、联电及中芯国际预计 Q4 公司的产能利用率下行，晶圆 ASP 走势平稳。特色工艺需求持续旺盛，华虹半导体预计产能利用率将保持满载运行，晶圆 ASP 上涨态势将延续。

2022 产能落地速度放缓，供给端增量或低于预期部分代工龙头的产能扩增速度有放缓趋势；联电 2023 年产能增长率预计不高于 5%，台积电调整延后了高雄厂 7 纳米制程的建设计划。此外台积电、联电下修 2022 年资本开支金额，华虹半导体下调 2023 年资本开支。

预计 2022 年晶圆代工的产能增量有限，全年产能增量低于年初预期。

投资建议

半导体产业下游需求保持结构性增长，新能源汽车、IOT 领域需求景气延续，带动半导体产业链内相关企业营收上行。2023 年需关注智能手机、PC 等传统消费电子的库存变动，本轮下行周期主要系需求疲软导致，若市场需求出现复苏，则国内晶圆代工龙头中短期受益于下游需求复苏带动，长期受益于国产化替代及新兴需求成长放量，业绩将保持平稳增长。

建议持续关注半导体行业，维持行业增持评级。

风险提示

产能扩产不及预期；市场需求下滑；技术研发不及预期；上游成本增幅超预期；宏观政策变化不及预期。

关键词：新能源 新能源汽车

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_48931

